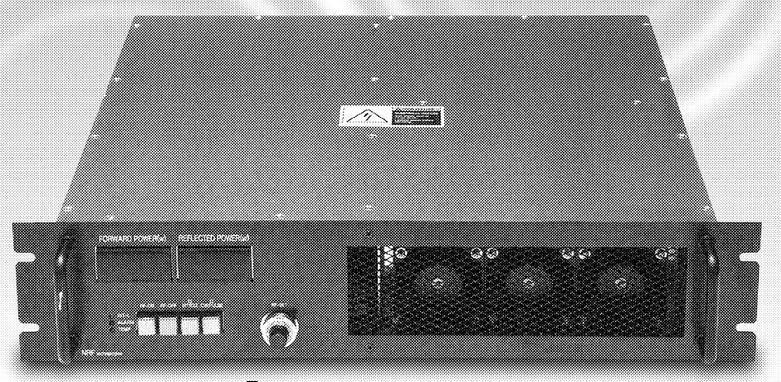
次世代高周波テクノロジー

NRF 株式会社ノダRFテクノロジーズ

ノダRFテクノロジーズは革新的な
高周波電源(RF-Generator)を提供し、
未来の半導体製造プロセスの開発に貢献致します。

・パルス応用技術
・高速マッチング技術
・周波数マッチングプロセス技術
・周波数重畳技術
・RFカットフィルター技術
・特殊仕様RF電源
・各種コンサルティング



セミコン・ジャパン2013
会期：12月4日(水)～12月6日(金)　会場：幕張メッセ
ブースNo：3ホール 3D-704

NRF 株式会社ノダRFテクノロジーズ
〒564-0054 大阪府吹田市芳野町5番12号(NRFビル)
TEL.06-6821-2222　FAX.06-6821-2081
http://www.n-rf.co.jp　ノダRF　検索

Lasertec　www.Lasertec.co.jp
Create unique solutions.
Create new value.

検査・計測の未来を創造

光応用技術をコアに、お客様の様々な問題を解決する斬新な製品をいち早くお届けし、
研究開発や生産性の向上に貢献してまいります。

SEMICON Japan2013
レーザーテックはSEMICON JAPAN 2013に出展します
■会　期：2013年12月4日(水)～6日(金)　■会　場：幕張メッセ
ブース番号：Hall5 前工程プロセス装置・部品ゾーン内 5A-407

レーザーテック株式会社　www.Lasertec.co.jp
□本　社：〒222-8552 横浜市港北区新横浜2-10-1　TEL：045-478-7111　FAX：045-476-1061

SEMICON Japan2013 見どころ

先端製造技術や化学物質管理対策を紹介

一つの半導体チップにより多くの回路を搭載するために回路線幅の微細化を進め、そのプロセスルールは今や10ナノメートル台に到達している。1枚のシリコンウエハーからより多くの半導体チップを取ることができるようにするため、ウエハーの大口径化も行われてきた。現在の直径は最大で12インチ、300ミリメートル。これを18インチ、450ミリメートルへと拡大する技術開発も行われている。また、半導体を垂直に積層し、3次元構造にする3D半導体（3D－IC）も注目の技術。セミコン・ジャパンでは最先端半導体製造を支える技術や製品、サービスが紹介される。

セミコン・ジャパンの展示ゾーンは大きく二つに分かれる。設計工程や設計ツール、ウエハー製造、ウエハープロセス工程といった前工程関連と、組み立てから試験・検査、さらには搬送関連にいたるまでの後工程関連を紹介する「メイン展示ゾーン」と中古装置やサプライチェーン、国・地域・自治体といったパビリオンで構成される「パビリオン展示」である。

今回、主催者のSEMIが特徴として打ちだしているのが展示パビリオンの強化だ。半導体関連および隣接産業との連携を紹介していくという。技術系ではこれまでの先端エレクトロニクスパビリオンに加え、今年から「先端製造技術パビリオン」を新設している。また、ビジネス系では「精密加工技術パビリオン」「化学物質管理対策パビリオン」を設置した。

「先端製造技術パビリオン」は後工程を中心とした展示が行われる。ホール1に設置され、3D－IC製造のカギとなるスルーシリコンビア（TSV＝シリコン貫通電極）の関連技術・製品や、3D半導体、450ミリメートルウエハーの実用化で注目をされる製造工程での搬送、ハンドリング装置などが紹介される。

業界自主基準であるSEMIスタンダード普及活動の一環で、このパビリオンにはSEMI特別展示コーナーが設置される。その一つがオープンフォーラムのFlowMaster Forumによる鉄道模型の走行デモンストレーション。日欧共同開発の太陽電池産業向けSEMI通信スタンダードが実装されたプログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）を走行制御に利用するというもの。PLCはファクトリーオートメーションのキーコンポーネントといえる製品。デモンストレーションを通じて、太陽電池産業のみならず他産業の製造ラインにも適用できる汎用性をもったSEMIのスタンダードを訴求する。

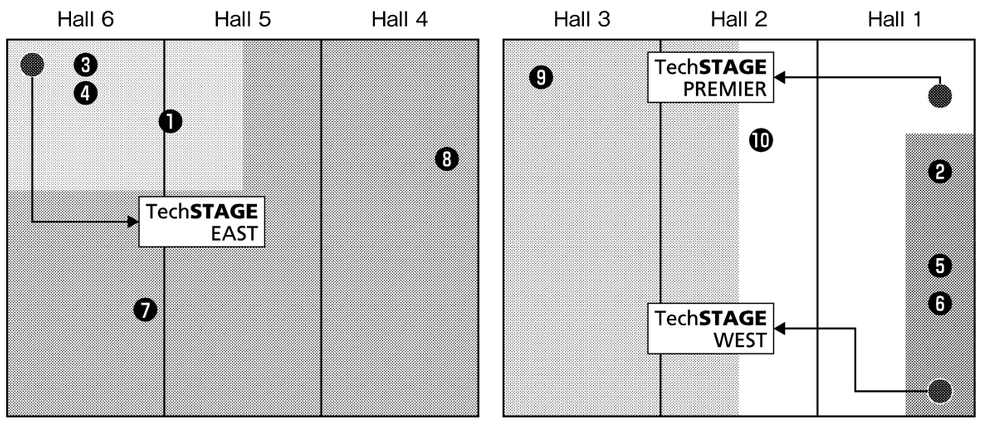
トップが語る 最新動向を講演で

今回のセミコン・ジャパンから新たな試みとして設置されるのが「SuperTHEATER」だ。国内外からトップエグゼクティブを講師に迎える聴講無料のコンファレンスイベント。国際会議場2階コンベンションホールAで3日間、半導体業界関係者にとっての重要課題や今後の展望など、九つのテーマの講演が行われる。

今回のセミコン・ジャパンで注目すべき技術である「3D－IC」「450ミリメートルウエハー」の最新動向はいずれも5日の「SuperTHEATER」で紹介される。

10時からの3D－ICサミット「飛躍のカギがここに」では東芝セミコンダクター&ストレージ社メモリー応用技術技師長の大島成夫氏が「フラッシュメモリの高速化と、パッケージ技術」と題した講演を行うほか、日立化成執行役社長の田中一行氏が3D－ICパッケージ材料を含む半導体材料について紹介する。また後工程の台湾大手メーカーであるASEグループや、ベルギーの研究開発会社imecからスピーカーを招く。

このほか、SuperTHEATERでは「米国大使館協賛ITフォーラム」「GSAフォーラム」「OSATエグゼクティブフォーラム」「PEサミット」などが開催される。



●展示会場内ステージ
❶先端エレクトロニクスパビリオン
❷先端製造技術パビリオン
❸精密加工技術パビリオン
❹化学物質管理対策パビリオン
❺中古装置パビリオン
❻サプライチェーンパビリオン
❼九州パビリオン
❽ドイツパビリオン
❾東北パビリオン
❿大田区パビリオン

SuperTHEATER プログラム

	12月4日(水)	12月5日(木)	12月6日(金)
10:00－12:00	オープニング キーノート	3D-ICサミット	PEサミット
12:30－14:30	米国大使館協賛 ITフォーラム	450㎜エグゼクティブ フォーラム	ITRS ブリーフィングセミナー
15:00－17:00	GSA フォーラム	OSATエグゼクティブ フォーラム	みらいビジョン フォーラム

HIWIN®
Motion Control and System Technology
お客様に付加価値を創造する

事業拡大で営業募集
詳細はホームページにて

セミコン・ジャパン2013 出展
小間番号：6C－705

ハイウィン株式会社 HIWIN CORPORATION
〒651-0087　神戸市中央区御幸通4丁目2－20　三宮中央ビル3階
Tel: (078)262-5413　Fax: (078)262-5686
http://www.hiwin.co.jp　E-mail: info@hiwin.co.jp
東京支店：Tel: (042)358-4501　Fax: (042)358-4519
名古屋支店：Tel: (052)587-1137　Fax: (052)587-1350
三河安城営業所：Tel: (0566)74-2911　Fax: (0566)74-6411
九州営業所：Tel: (096)340-2282　Fax: (096)340-2286
ロボット事業部：Tel: (042)358-4503　Fax: (042)358-4518

samco®
PARTNERS IN PROGRESS

NEW

省エネルギー化を推進する
パワーデバイス分野向け新製品

SiC高速エッチング装置
RIE-600iPC

SEMICON Japan2013
NEXT SAMCO Material Innovation
会　期　2013年12月4日(水)～6日(金)
会　場　幕張メッセ
ブース　No.3A-605(HALL3)
皆様のご来場をお待ちしております。

サムコ 株式会社　東証二部　証券コード 6387
deposition　etching　surface treatment
本　社　〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町 36　TEL(075)621-7841　FAX(075)621-0936
www.samco.co.jp
国内拠点　京都・東京・東海・つくば・仙台・広島　海外拠点　中国・台湾・韓国・ベトナム・シンガポール・アメリカ・イギリス